



Rundbolzen/Walzplatten *Billets/Cakes*

MB-P 500

Bezeichnung

Kupfer mit sehr hohem Phosphorzusatz ohne definierte elektrische Leitfähigkeit

Spezifikationen

- Phosphorgehalt: 400-600 ppm
- Sauerstoffhaltige Schmelze mit Phosphor desoxidiert
- Chemische Zusammensetzung in ppm / Gew %

Designation

Copper with very high phosphorus without defined electrical conductivity

Specifications

- Phosphorus content: 400-600 ppm
- Melt deoxidized with phosphorus
- Chemical composition in ppm / wt %

Vergleich Comparison	Garantiewerte Guaranteed value	Typische Werte Characteristics
Cu + Ag + P	≥ 99,9 %	≥ 99,97 %
Bi-Gehalt	≤ 5	1
Pb-Gehalt	≤ 50	15
P-Gehalt	400-600	500
Beständigkeit gegen Wasserstoffversprödung Hin-, Herbiegetest nach ISO 2626 <i>Resistance against hydrogen embrittlement Reverse Bend Test according to ISO 2626</i>	≥ 4 Biegungen bzw. 180° Umbiegung ≥4 reversals or 180° bend	8 Biegungen 8 reversals
Elektrische Leitfähigkeit <i>Electric conductivity</i>	-	60,3 % - 72,4 % IACS

Anwendung

- Schüttgutanoden in der Galvanotechnik

Application

- Copper anodes for electroplating

Vergleich mit internationalen Normen

Comparison with international standards

Norm Regelwerk Standard	Bezeichnung Name	Abweichung im Vergleich zur angeführten Norm Deviation from mentioned standard
EN 1976	Cu-DXP (CR 025A)	Höhere Reinheit <i>higher purity</i>
Anm.: Diese Kupferqualität scheint in den Normen ISO und ASTM nicht auf. <i>Note: This copper grade does not appear in the standards ISO and ASTM</i>		